



光纤激光陶瓷激光加工设备

Fiber laser ceramic laser processing equipment

可应用于LED陶瓷基板支架钻孔切割；汽车&LED陶瓷电路板划片；手机背板，3C电子等智能终端电子产品；钟表齿轮&眼镜外框精密外形切割；听筒音筒钻孔。

- 无应力非机械接触加工，dxf文档导入，可加工任意图形；
- 光斑小，线宽细，峰值能量高，实现较高的加工效率，热影响区域微小；
- 辅助机器视觉及自动校准，具备高精度图像识别定位功能，操作方便快捷；
- 电光转换效率>30%，风冷式紧凑型产品；光纤激光器稳定高且运行免维护；
- 可以灵活搭配上下料机构，实现自动化操作。

主要技术参数

平台移动范围 (mm)	350×350 (可选)
最大切割尺寸 (mm)	300×250 (可选)
切割速度 (mm/s)	≤50
划线速度 (mm/s)	≥200
定位精度 (mm)	±0.003
重复定位精度 (mm)	±0.002
最小切割线宽 (mm)	≤0.02
切割厚度 (mm)	≤2
加工最小的孔 (mm)	φ0.05
加工精度 (mm)	≤±0.005
设备尺寸 (mm)	1400×1200×1700
设备重量 (kg)	约1500

